

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2025-010

浙江亨通控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）。

●本次担保是否为关联担保：否

●本次担保金额：28,664.58 万元

●截至披露日已实际为被担保人提供的担保余额：28,664.58 万元（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证全资子公司亨通铜箔经营发展资金需求，公司于近日与中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行（以下简称“中行龙泉驿支行”）签署了《保证合同》（编号：2025 年 HTKG 保字第 001 号），为亨通铜箔收购德阳经开区通亨商业管理有限公司 100%股权向中行龙泉驿支行申请的银行贷款 18,664.58 万元提供连带责任担保；与中行龙泉驿支行签署了《保证合同》（编号：2025 年 HTKG 保字第 002 号），为亨通铜箔向中行龙泉驿支行申请的流动资金贷款 10,000.00 万元提供连带责任担保。本次担保期限为债务履行期限届满之日起三年，上述担保不存在反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第十六次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了

《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司亨通铜箔提供额度不超过人民币 90,000 万元的担保，并授权公司董事长或其授权代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日和 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-061）和《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-066）。

本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

统一社会信用代码：91510600MA7EDEMJ74

注册地：四川省德阳市旌阳区八角井街道雪山路 888 号（南湖路与雪山路交汇处西南角）

法定代表人：张卫强

注册资本：60,000 万元

成立日期：2021 年 12 月 8 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 132,138.82 | 110,445.82 |
| 负债总额 | 89,939.50 | 63,634.00 |
| 净资产 | 42,199.32 | 46,811.82 |
| 项目 | 2024 年 1-9 月 (未经审计) | 2023 年度 (经审计) |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 43,447.61 | 4,328.17 |
| 净利润 | -5,036.54 | -2,553.62 |

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）《保证合同》（编号：2025年HTKG保字第001号）主要内容：

债权人：中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行

被担保人：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

保证人：浙江亨通控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：被担保的主债权本金金额为人民币18,664.58万元

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

保证范围：主合同项下主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（二）《保证合同》（编号：2025年HTKG保字第002号）主要内容：

债权人：中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行

被担保人：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

保证人：浙江亨通控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证金额：被担保的主债权本金金额为人民币10,000.00万元

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

保证范围：主合同项下主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司亨通铜箔提供担保，有助于满足其经营发展资金需求，推进公司转型发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保金额未超过公司

董事会及股东大会授权的担保额度范围。被担保人亨通铜箔生产经营正常、资信状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额（含本次担保）为28,664.58万元，占公司2023年度经审计净资产的8.80%。公司为亨通铜箔实际提供的担保余额（含本次担保）为28,664.58万元，占公司2023年度经审计净资产的8.80%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年3月29日